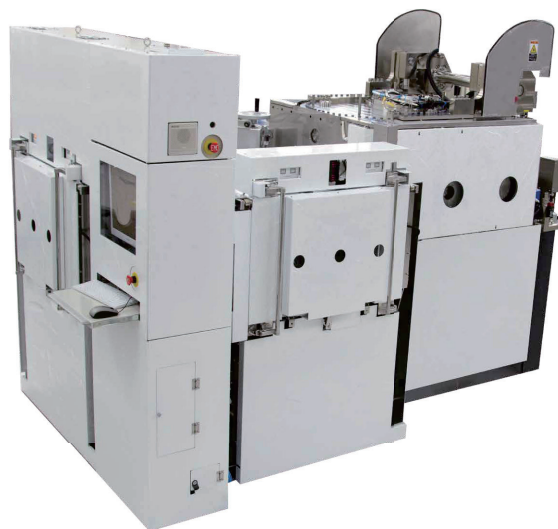


Bonding without pressurizing nor heating

加圧・加熱なしの接合

Atomic Diffusion Bonding Equipment BC7000
原子拡散接合装置 BC7000



加熱不要

Without heating

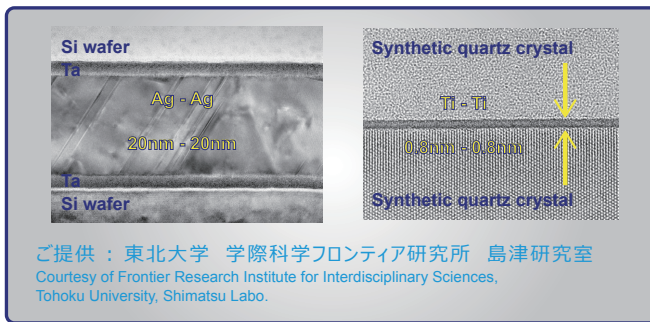
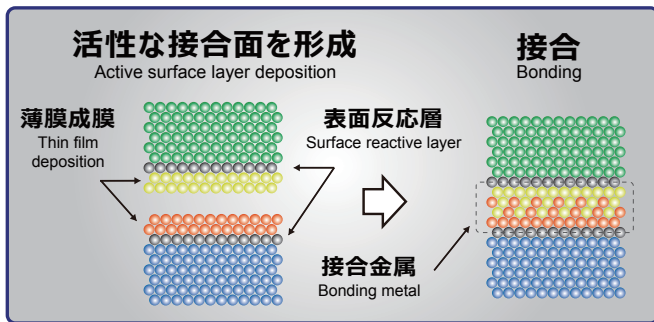
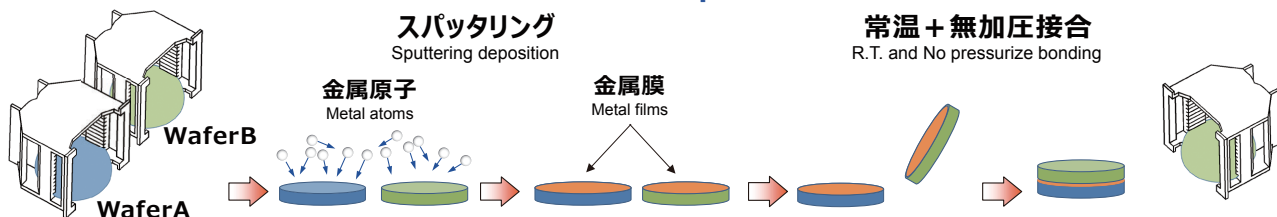
加圧不要

Without pressurizing

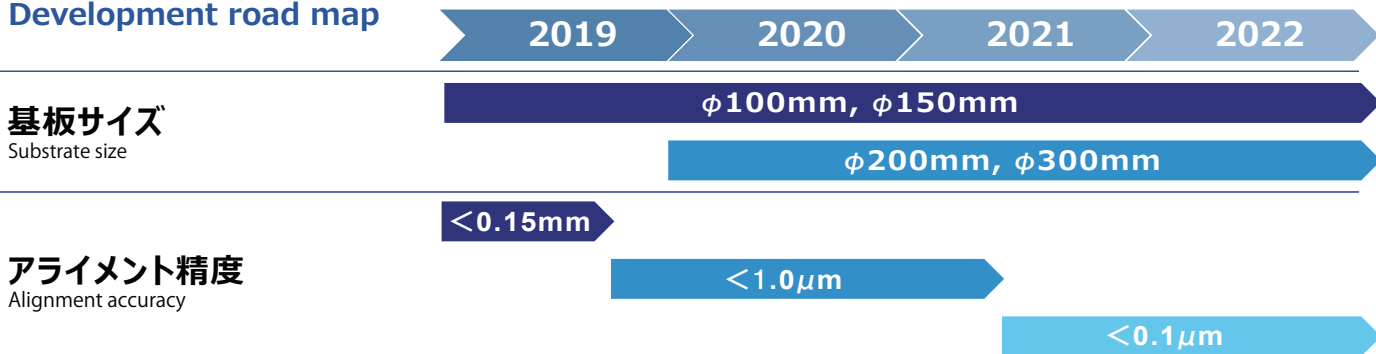
異種材料

Hetero-bondings

真空一貫プロセス In situ vacuum process



開発ロードマップ Development road map



Surface roughness improvement technology by new sputtering method

表面荒さを改善する新スパッタ法

Energy Treatment Sputtering エネルギートリートメントスパッタリング

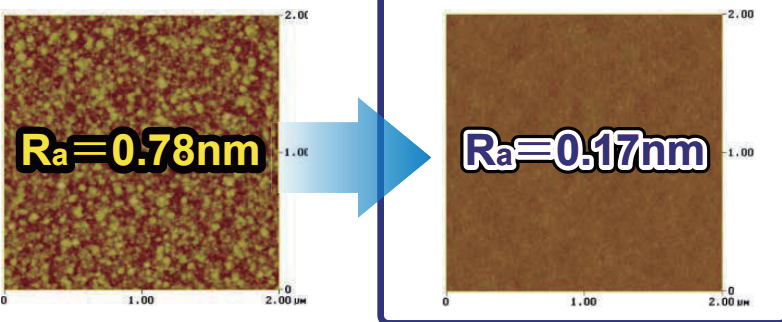
成膜による高平坦化

Fabrication of high smooth deposition film



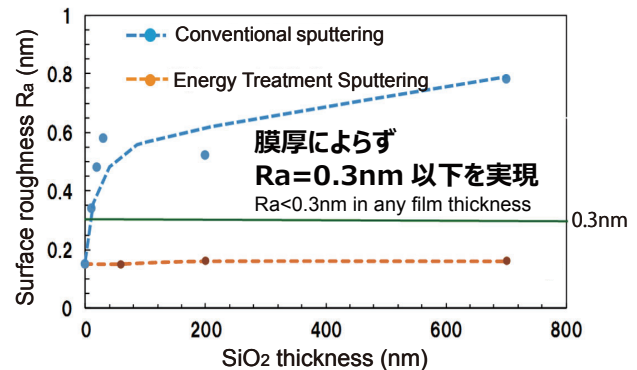
従来スパッタ
Conventional sputtering

エネルギートリートメント
スパッタリング
Energy Treatment Sputtering



従来スパッタとエネルギートリートメント スパッタリングの平坦性比較

Surface roughness comparison between conventional sputtering and energy treatment sputtering



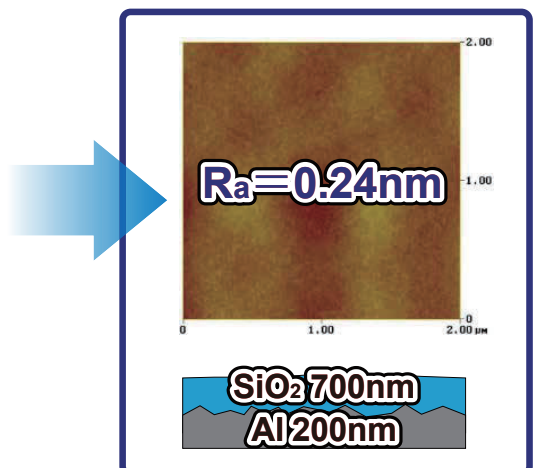
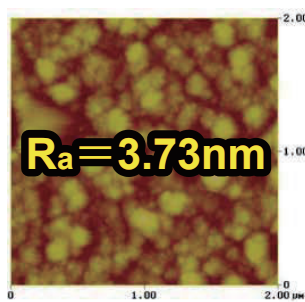
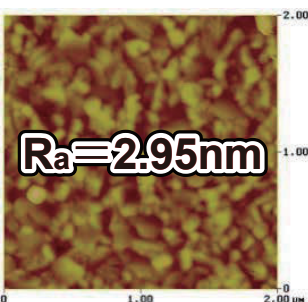
成膜による荒れた表面の平坦化

Smoothing of rough surface by deposition

初期表面
Initial surface

従来スパッタ
Conventional sputtering

エネルギートリートメント
スパッタリング
Energy Treatment Sputtering



Al 200nm

SiO₂ 700nm
Al 200nm

SiO₂ 700nm
Al 200nm